



Grinding Wheels

IF SERIES

高质量，高性能，高稳定性的研削磨轮

对IF系列磨轮的高度可信赖性来源于其优越的研削能力

迪思科公司成功开发出适用于纵向切入式研削机的IF系列研削磨轮。该系列除了能够研削硅晶圆以外，还可以研削磨加工其它电子组件用结晶材料。迪思科公司不但提供多种类型的研削磨轮，还为用户提供和推荐在加工不同材料及尺寸的工作物时所需的应用加工技术及加工参数。

- 优越的精加工精度和稳定的研削能力
- 磨轮耐磨性优良，使用寿命长
- 产品种类丰富，还可以加工化合物半导体晶圆及电子组件用结晶材料
- 采用环保型PP（聚丙烯）包装或ABS树脂包装



产品种类

■粗研削加工用

将高刚性的陶瓷结合剂与大粒度磨粒有机结合，可实现稳定的研削加工。

VS: 标准型

■精研削加工用

通过采用树脂结合剂，大幅度降低对晶圆损伤，使研削加工更趋于稳定。另外，还改善了晶圆厚度精度（TTV）及表面粗糙度，并且在兼顾使用寿命的同时，还提高了研削加工质量。

B-K01: 重视研削加工性型

B-K02: 重视耐磨性型

B-K04: 标准型

B-K09: 重视难研削性型

■研削加工已蚀刻晶圆用（面向晶圆制造厂商）

通过直接研削已被蚀刻的晶圆，可获得良好的加工质量。

B-M01: 标准型

■自研削用研削磨轮

作为研削机维修保养的一个重要项目，在平整工作台自研削时使用。

IF-01-1-20/30-VS: 标准型工作台自研削用磨轮

加工对象

硅（矽）晶圆、化合物半导体晶圆、电子元件用结晶材料、其他材料

技术规格

研削齿排列		颗粒大小		结合剂		研削齿高度	研削齿宽度
1 标准	320 #320	粗研削加工用 (T1轴用)		VS	4.0	4.0	
9 正圆形	40/60 #360	精研削加工用 (T2轴用)		B-K01	5.0	4.0	
	30/40 #400			B-K02	5.0	4.0	
	20/30 #600			B-K04	5.0	2.0	
	10/20 #800			B-K09	5.0	3.0	
	8/20 #1000			B-M01	5.0	2.0	
	8/16 #1200	蚀刻晶圆研削用					
	5/12 #1400						
	5/10 #1500						
	4/8 #1700						
	4/6 #2000						
2/6 #3000							
2/4 #4000							

※1 包括特殊用途在内的产品，有时会以BGT-****表示。

有关研削磨轮的选择

研削效果会由于粗研削磨轮与精研削磨轮组合方式不同而发生很大变化。

因此本公司会按照工作物的材料及所要求的加工精度，向用户推荐最佳的研削磨轮组合方式。

不同结合剂的研削齿尺寸 (mm)
上表为标准尺寸。根据实际应用情况和不同的组合方式，用户的适用尺寸有时可能会与上表有出入。

本公司的所有产品都已加入产品赔偿责任保险。

下订单时

在下订单时，请用户将产品的名称、外径、研削磨轮直径及数量通知本公司。另外在初次订购时，本公司销售窗口会根据不同加工要求，协助用户选择适合的产品。届时请一并提供研削材料、尺寸、形状、所用设备(装置)及其它相关加工条件等数据。
· 为了改进产品，本公司可能在未通知用户的情况下，就对产品规格进行变更，因此请仔细核对规格后再下订单。



为了安全使用本公司的各种产品

为了预防发生因研削磨轮、切割刀片(以下通称精密加工刀具)的破损而造成的各种事故和人身伤害，请严格遵守下列各注意事项。

- 请使用安全挡板(包括喷嘴外壳或外盖)。
- 在使用注有限制旋转数的精密加工刀具时，请不要超出其规定的旋转数范围。
- 在安装精密加工刀具时，请遵照设备(装置)使用说明书的规定，正确地进行安装。
- 请不要使精密加工刀具掉落在地上，或发生碰撞。
- 在每次使用精密加工刀具前必须先进行检查，如果有缺口或其它破损，请停止使用。
- 在开始使用前，请先仔细阅读相关设备(装置)的使用说明书。
- 请不要使用经过改装的设备(装置)。
- 请不要使用不符合设备(装置)指定尺寸的精密加工刀具。
- 除了研削、切割及切削作业以外，请不要使用在其它用途。
- 在使用湿式研削、切割用精密加工刀具时，请使用冷却液。